# IHEP School of Computing 2023

# 高能物理计算概述

程耀东

chyd@ihep.ac.cn







# 主要内容

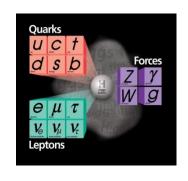
- 高能物理数据处理的挑战
- 高能物理科学计算平台
- 计算机体系结构发展变化
- 未来发展趋势



## 高能物理科学研究

#### 物质结构组成 (理论)

- 夸克、轻子、玻色子
- 强力、弱力、电磁力、万有引力



#### 探测器 (实验)

- 探测各类粒子,用于科学研究
- BESIII, JUNO, LHAASO, ATLAS, CMS ...

#### 粒子加速器(装置)

- 粒子物理研究的重要手段之一
- BEPCII, LHC, CEPC等等



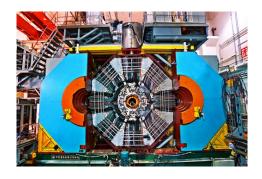
#### 数据分析(科学发现)

- 暗物质/暗能量
- 宇宙起源、...



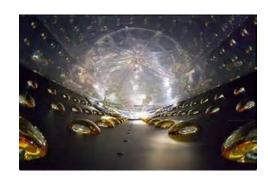
## 高能物理实验数据挑战

- 北京正负电子对撞机BECPII/BESIII
  - 每年~1PB raw data, 已经积累20PB+
- 中微子实验
  - 大亚湾中微子实验已经积累>2PB原始数据
  - 江门中微子实验每年将产生3PB数据
- 高海拔宇宙线实验LHAASO
  - 位于四川稻城海子山,海拔4400米
  - 目前已经运行,每年产生10PB以上的数据
- 高能同步辐射光源HEPS
  - Avg 290PB/year原始数据, 单个实验数据产生速率> 400Gbps
- 高能空间天文实验HXMT/HERD/eXTP/GeCAM 等全部运行后预计每年将产生10PB数据
- 阿里原初引力波、中国散裂中子源、南方光源等







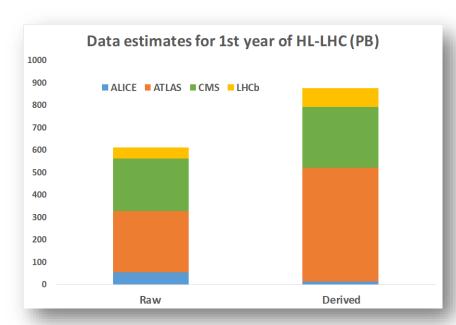


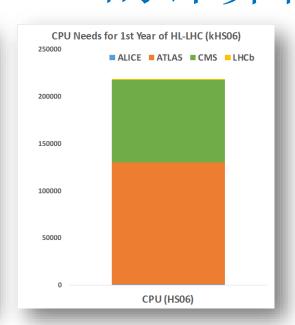


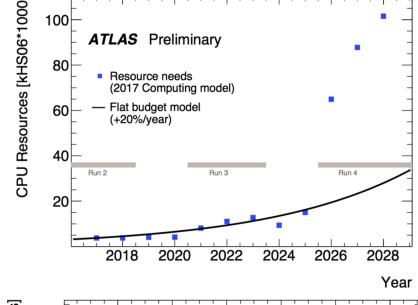




# HL-LHC的计算需求







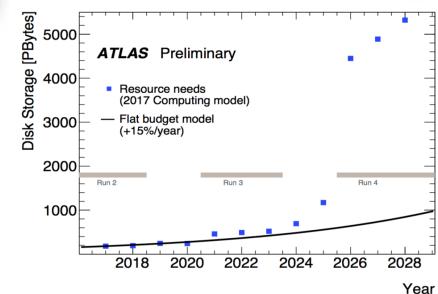
## 数据与计算挑战:

原始数据 2016: 50 PB → 2027: 600 PB

处理后的数据 (1 copy): 2016: 80 PB → 2027: 900 PB

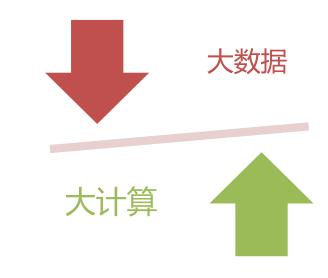


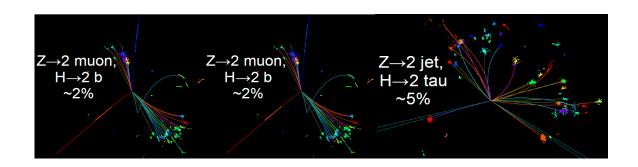
- 10倍以上的存储需求
- 60倍以上的计算需求
  - 假设未来计算机技术平均每年有20%的提升,10年将有6倍 的技术提升,仍需要在计算资源方面增加越10倍左右的投入



## 高能物理实验计算

- 高能物理科学研究能否成功依赖于计算技术的发展
- 实验采集到的数据需要强大的计算系统对其进行分析处理
- 物理模拟及理论计算需要强大的高性能计算支撑
- 不同的数据处理任务采用不同的计算模式
  - 粒子加速器和探测器的计算机模拟设计: 计算密集型
  - 粒子探测器观测到的海量科学数据的分析处理: 数据密集型
  - 高能物理理论研究中的高强度的科学计算: 计算密集型
    - 例如格点量子色动力学(格点QCD)和计算宇宙学



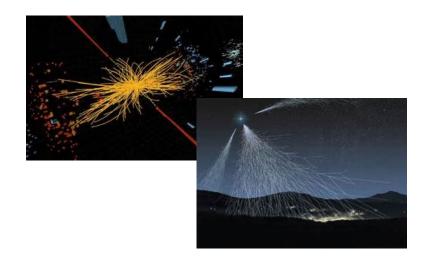


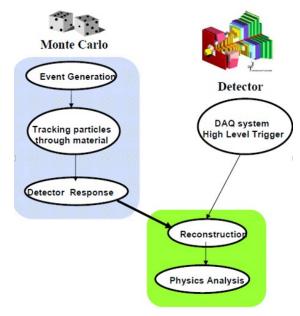
## 高能物理领域已经步入EB级的大数据时代



# 数据处理过程

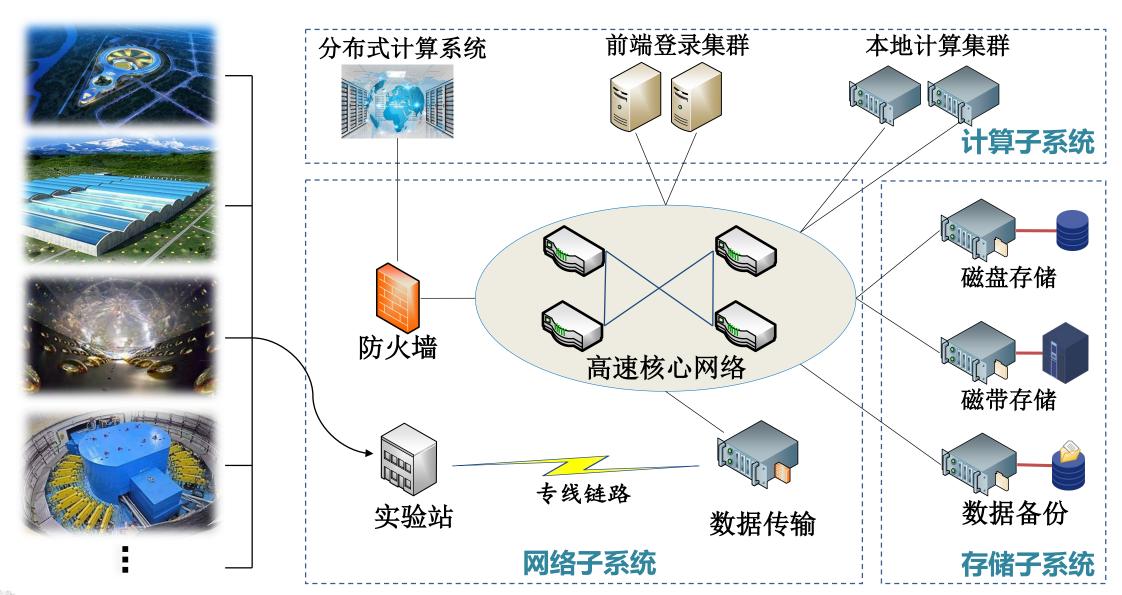
- 事例: 一次粒子对撞或者一次粒子间的相互作用
  - 粒子物理研究的基本对象
- 探测器记录事例,产生原始数据
  - 以二进制格式记录的探测器信号
  - 由计算机产生模拟实验的蒙特卡罗模拟数据,数字化
- 事例重建
  - 读出Raw/MC Raw数据,处理后产生相关物理信息,如 动量、对撞顶点等;
- 数据分析
  - 由上千个属性组成的Event文件,提供物理学家进行 分析,并最后产生物理结果







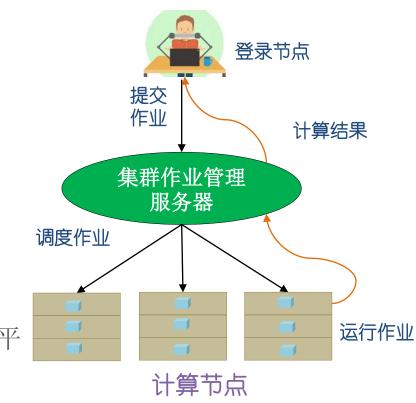
# 典型的高能物理计算平台





# 本地计算集群

- 管理计算节点,调度作业
- 提供用户提交作业接口
- PBS
  - 开源,简单,历史悠久
  - OpenPBS, PBS Pro, Torque
  - IHEP在2016年以前的调度系统
- HTCondor
  - HTC: High Throughput Computing
  - 开源, 更好的性能, 更多的功能, 调度算法更为公平
  - IHEP现有调度系统
- SLURM: 高性能计算调度
  - HPC: High Performance Computing
  - GPU、MPI等作业调度
- LSF: 商业调度软件





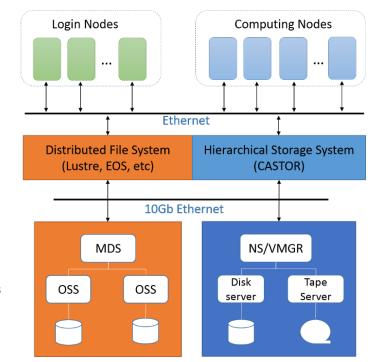




## 存储系统

- 磁带存储系统
  - 将顺序设备映射成类似于存储系统的树形目录
  - CERN CASTOR/CTA, enstore等开源软件
  - TSM/HPSS等商业软件
- 磁盘存储系统
  - 分布式文件系统 Lustre、**EOS**、BeeGFS,GPFS、...
  - 应用层存储系统 dCache、HDFS、EOS、...
- 用户目录
  - AFS
- 软件库共享系统
  - AFS, CVMFS





Storage Devices

Storage Client

Storage System

8/17/2023

# 高能所计算集群





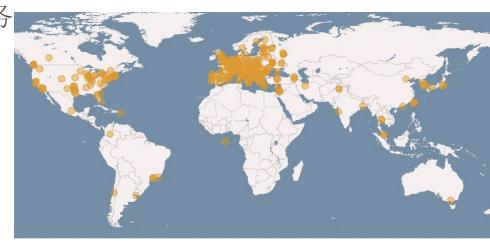
## 运行监视

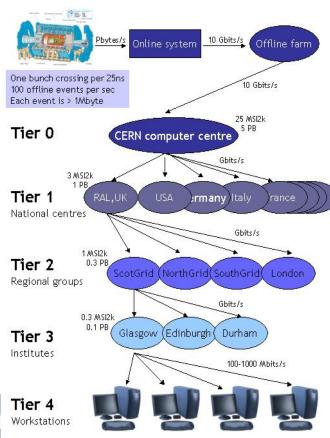




## WLCG网格

- WLCG: WorldWide LHC Computing Grid
- Tier 0: CERN
  - 接收原始数据,保存在磁带系统中,并进行第一遍数据重建
  - 向Tier1分发数据
- Tier1: 15个
  - 提供原始数据备份
  - 执行数据重建、分析等任务
  - 提供数据分发等网格服务
- Tier2: 145个
  - 执行模拟、数据分析等任务
- Tier3: 本地系统



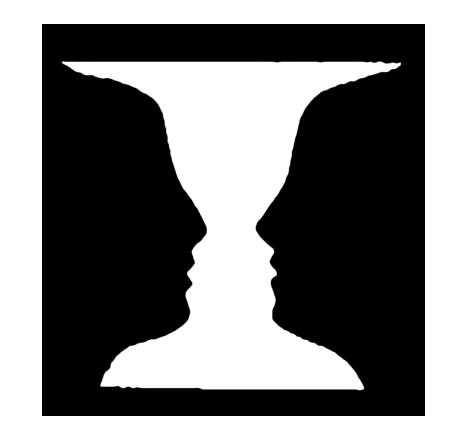


2023高能物理计算暑期学校

14

8/17/2023

换个角度来看? ——计算机体系结构

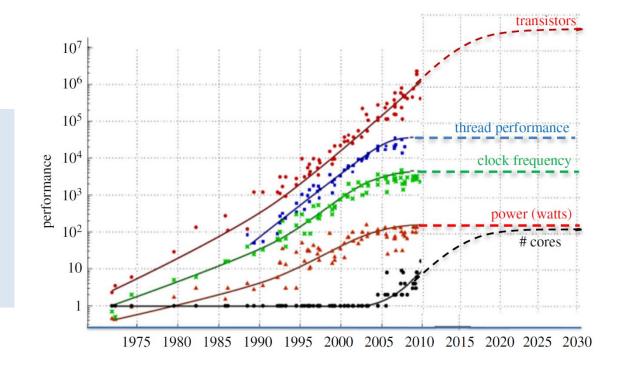


## 摩尔定律

- 二十一世纪以来,摩尔定律发展放缓,甚至面临失效
- 1) 晶体管尺寸因不断逼近物理极限而减缓微缩,特别是进入10纳米以后更加趋缓
- 2) 因芯片过热而不可无限提升主频,现大多控制在4GHz以内
- 3) 处理器自遭遇主频

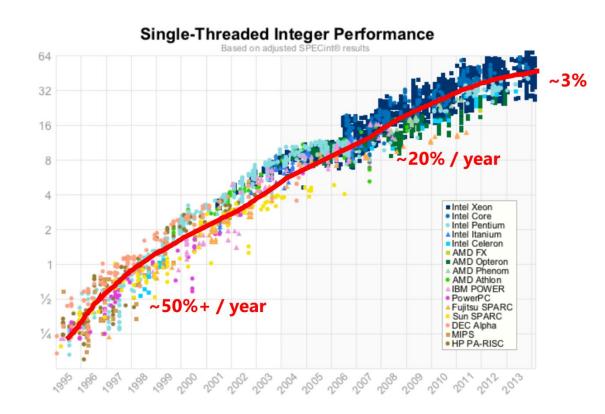
升级瓶颈后,转向多核架构

狭义的摩尔定律指每18到24个月,芯片上晶体管集成的密度会翻一番或者价格下降一半。普遍所讨论的是摩尔定律其实包含"摩尔定律"、"登纳德缩放"和"波拉克法则"三个重要法则。





## CPU核面临瓶颈



INTEL'S NEXT MAJOR ARCHITECTURE Core 2 (intel) (intel) Core Core inside" CORE"i7 CORE 17 CORE 17 2008 2011 2013 2019 **SKY LAKE MEROM NEHALEM** HASWELL **ICE LAKE** 22nm 65nm 45nm 32nm

https://preshing.com/20120208/a-look-back-at-single-threaded-cpu-performance/

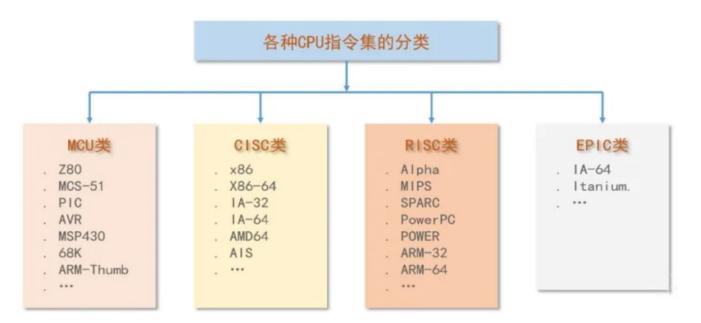
制程 (Fabrication Process)

CPU 制造厂商也都有各自的路线图来实现更小的制程,例如台积电、三星等在 2022 和 2023 年实现 3nm 和 2nm 的制造工艺

8/17/2023

## CPU指令集

- 计算机指令是计算机硬件直接能识别的命令
- 指令集架构是指一种类型CPU中用来计算和控制计算机系统的一套指令的集合
- 三种指令集
  - 复杂指令集CISC (Complex Instruction Set Computer)
  - 精简指令集RISC (Reduced Instruction Set Computing)
  - 精确并行指令集EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computers)

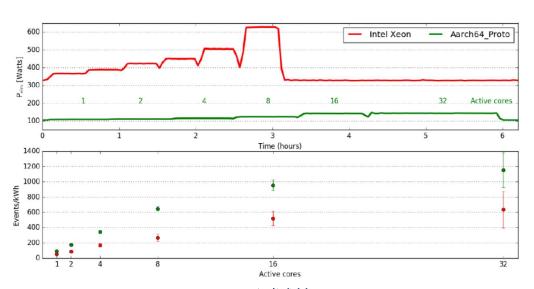


| 指令集路线 | 国产 CPU 厂商 |  |
|-------|-----------|--|
| MIPS  | 龙芯        |  |
| x86   | 海光        |  |
|       | 兆芯        |  |
| ARM   | 飞腾        |  |
|       | 鱼昆鹏       |  |
| Alpha | 申威        |  |



## ARM指令集及发展

- 在移动设备等领域占有率高
  - ARM 应用于智能手机>99%、车载信息设备>95% 、可穿戴设备>90%。
- ARM通过三种授权模式,应用生态完善
  - 使用层级、内核层级、架构/指令集层级

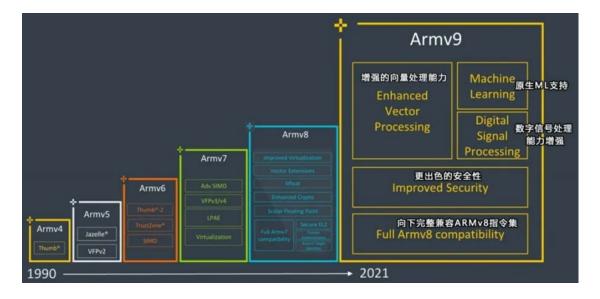


 x86
 ARM

 重核多核多线程 高主频
 轻核、众核

| 扩展性 | 重核多核多线程<br>高主频            | 轻核、众核            | 具有更好的并<br>发性能   |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 指令集 | CISC, 通用指令集               | RISC, 根据负载优化     | 匹配业务特征<br>能耗比更佳 |
| 供应商 | 只有两家CPU供应商<br>Intel处于垄断地位 | 开放的授权策略<br>众多供应商 | 更加灵活丰富<br>的选择   |
| 产业链 | 成熟                        | 完善中              | 业界热点<br>快速发展    |





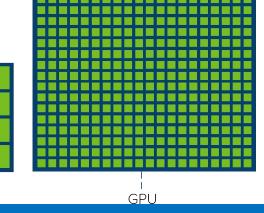
## **GPU**

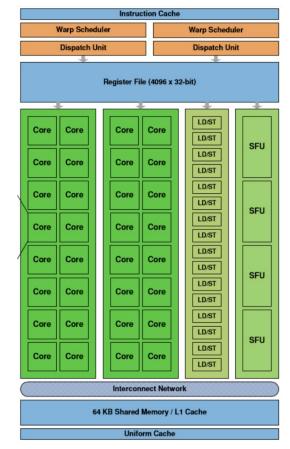
- 图形处理单元: Graphics Processing Unit, GPU
- 其设计与 CPU 完全不同,主要提高系统的吞吐量,在同一时间竭尽全力处理更多的任务
- 最初加速图片创建与渲染,由于其高度并行性,在AI及大数据处理方面得到广泛应用
- 流式多处理器(Streaming Multiprocessor, SM)是 GPU 的基本 单元,包含以下部分:
  - 线程调度器(Warp Scheduler): 线程束(Warp)是最基本的单元, 包含 32 或更多的并行的线程
  - 访问存储单元(Load/Store Queues): 在核心和内存之间快速传输数据
  - 核心(Core): GPU 最基本的处理单元,也被称作流处理器
  - SM 中还包含特殊函数的计算单元(Special Functions Unit、SFU)

以及用于存储和缓存数据的寄存器文件

(Register File)、共享内存(Shared Memory),

一级缓存和通用缓存等



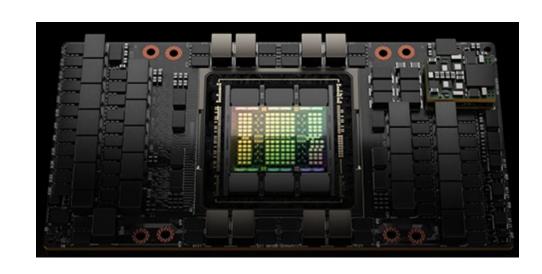




## Nvidia Hopper H100架构

- 144个流式多处理器SM,每个SM有128个FP32内核、64个FP64内核和64个INT32,以及4个Tensor Core; 800亿个晶体管,4nm工艺
- H100 GPU在FP16、FP32和FP64计算方面比A100快三倍,在8位浮点数学运算方面快六倍
- 专用核心以支持机器学习等特定应用
  - 比如: 张量核心(Tensor Core)和光线追踪核心(Ray-Tracing Core)
  - cuQuantum加速量子计算模拟
- · 功耗达到惊人的700W!

|                  | H100         | H100         |
|------------------|--------------|--------------|
|                  | SXM          | PCIe         |
| FP64             | 30 TFLOPS    | 24 TFLOPS    |
| FP64 Tensor Core | 60 TFLOPS    | 48 TFLOPS    |
| FP32             | 60 TFLOPS    | 48 TFLOPS    |
| TF32 Tensor Core | 1000 TFLOPS* | 800 TFLOPS*  |
| BFLOAT16         | 2000 TFLOPS* | 1600 TFLOPS* |
| Tensor Core      |              |              |
| FP16 Tensor Core | 2000 TFLOPS* | 1600 TFLOPS* |
| FP8 Tensor Core  | 4000 TFLOPS* | 3200 TFL0PS* |
| INT8 Tensor Core | 4000 TOPS*   | 3200 TOPS*   |
| GPU 显存           | 80GB         | 80GB         |
| GPU 显存带宽         | 3TB/s        | 2TB/s        |
| 解码器              | 7 NVDEC      | 7 NVDEC      |
|                  | 7 JPEG       | 7 JPEG       |
| 最大热设计功耗<br>(TDP) | 700 瓦        | 350 瓦        |

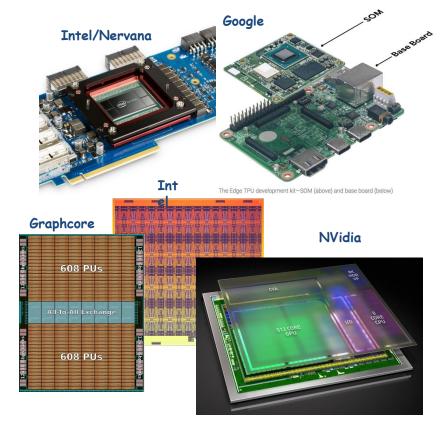




## **ASIC**

- ASIC(Application Specific Integrated Circuit):专用集成电路芯片
  - 针对用户对特定电子系统的需求,固定算法最优化设计
  - ASIC 芯片模块可广泛应用于人工智能设备、军事国防设备等智慧终端
  - 比如: NPU (Neural Networks Process Units), TPU(Tensor Processing Units), …
- 优点: 面积小、能耗低、集成度高、价格低
- 缺点: 设计周期长、更新频繁、市场风险高





| Source           | NPU                   |
|------------------|-----------------------|
| Amazon           | AWS<br>Inferentia     |
| Alibaba          | Ali-NPU               |
| Baidu            | Kunlun                |
| <u>Bitmain</u>   | <u>Sophon</u>         |
| <u>Cambricon</u> | MLU                   |
| Google           | TPU                   |
| <u>Graphcore</u> | <u>IPU</u>            |
| <u>Intel</u>     | NNP, Myria<br>d, EyeQ |
| <u>Nvidia</u>    | <u>NVDLA</u>          |
| Huawei           | Ascend                |
| <u>Apple</u>     | Neural<br>Engine      |
| Samsung          | NPU                   |



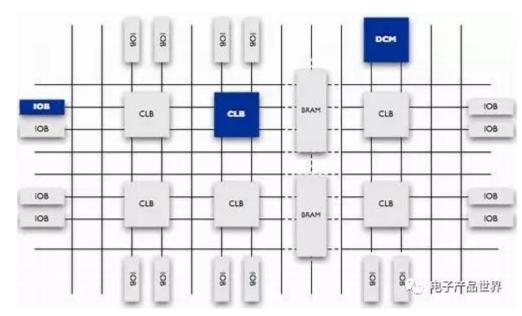
8/17/2023

## **FPGA**

- FPGA (Field Programmable Gate Array): 现场可编程门阵列
  - 先购买再设计的"万能"芯片
  - FPGA流片即可以成为ASIC
- 特点
  - 特定的FPGA硬件比通用的CPU更快更高效
  - 与CPU/GPU相比,更节能
  - 与ASIC相比,随时可以更改硬件配置: 100ms-1s
  - 用量小时,不需要ASIC流片,成本低
- 内部结构
  - 可编程输入输出单元(IOB)
  - 可配置逻辑块(CLB)
  - 数字时钟管理模块(DCM)
  - 嵌入式块RAM (BRAM)
  - 丰富的布线资源
  - 底层内嵌功能单元







## FPGA的并行性

- FPGA支持SIMD,MISD等多种形式的并行化
  - 对于MISD类的应用,即单一数据需要用许多条指令并行处理,FPGA更有优势
- 通过调整硬件资源,在特定的算法上FPGA的性能会超过GPU,因为GPU的硬件资源不能改动
- FPGA的功耗(~10W)远远低于GPU卡(~200W)
- 目前,FPGA在科研领域及大数据等方面应用较多



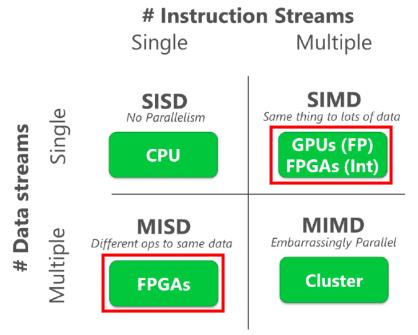












8/17/2023

## **DPU**

- 数据处理单元 (Data Processing Unit, DPU)将成为继CPU、GPU的第三块主力芯片
- DPU主要应用场景
  - 算力卸载: 作为通用算力补充, 提供可编程和开放性
  - 存算结合: 通过小型化、算力融合实现单位空间、单位功耗下最优处理效率
  - 以数据为中心: 提升数据处理性能, 以算力换空间

• DPU算力在数据密集型计算中的比例逐渐提升

• DPU主要实现模式

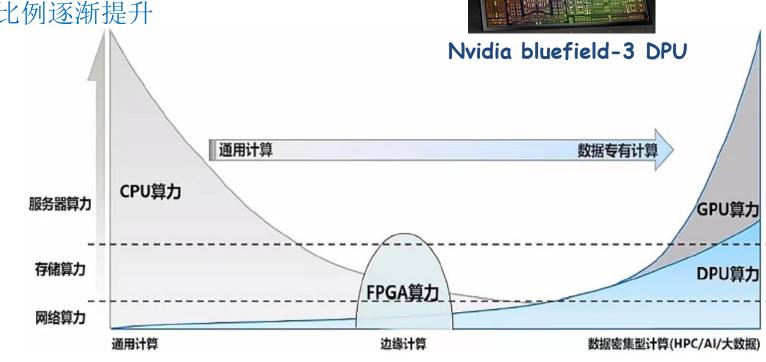
基于FPGA的DPU

基于ASIC的DPU

基于多核芯片MP的DPU

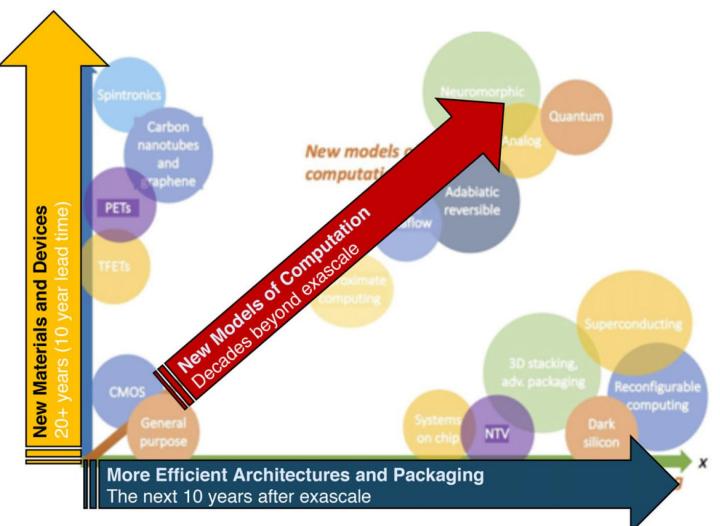
SoC-GP

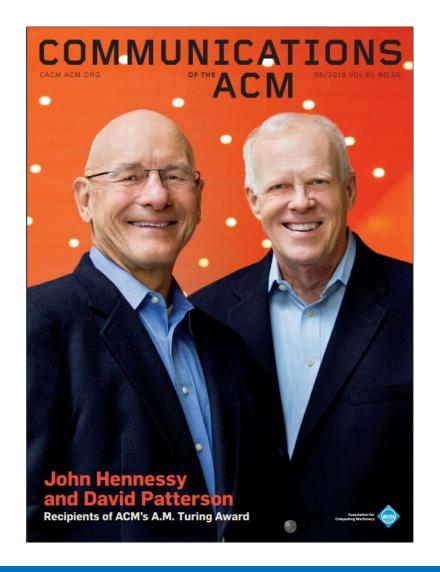
SoC-NP





## A New Golden Age for Computer Architecture?





Source: http://dx.doi.org/10.1145/3282307 (2019)



## 现阶段一些发展方向

#### • 异构计算渐成主流

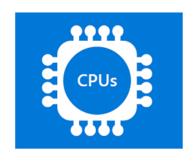
- CPU、GPU、DPU、FPGA、ASIC是目前通用计算领域的主流计算芯片
- CPU芯片兼顾控制和计算,是构成笔记本、智能终端及服务器计算硬件主体
- GPU芯片适合通用并行处理,应用领域由早期图像处理拓展至通用加速
- FPGA芯片具备可重构特性,适合于需要定制的航空航天、车载、工业、科学计算等领域
- AI ASIC芯片现已成为专用计算加速芯片创新的典型代表(TPU、寒武纪、...)

#### • 异构计算软件作用日益凸显

- 从硬件开发转移到深化应用、软硬件融合创新阶段,软件对异构计算的支撑作用越来越明显
- 数据中心异构体系开启由GPU到DPU/FPGA的新变革
  - 将 "CPU处理效率低下、GPU处理不了"的负载卸载到DPU/FPGA等专用芯片
- 高性能计算(超算、HPC)已经成为集群计算的重要应用领域
  - 2021年全世界开始步入E级计算时代
  - 格点QCD、宇宙学模拟、粒子物理模拟等是HPC重点应用



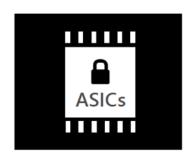
# 异构计算部件











**FLEXIBILITY** 

**EFFICIENCY** 

# 再回到高能物理数据处理——软件的挑战与发展



计算硬件的变迁

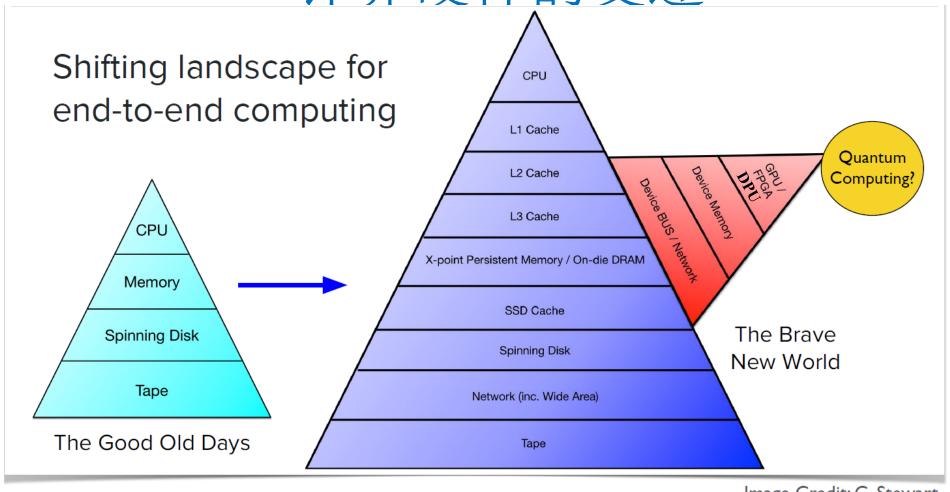


Image Credit: G. Stewart

- 计算加速部件是异构的, 软硬协同, 编程是不统一的
- 如何整合到高能物理数据处理? 给高能物理软件带来了巨大的挑战!

## 并行处理

- 现代处理器硬件的一个核心特征是"并行处理"
  - SIMD Single Instruction Multiple Data (vectorisation)
    - 在多个数据对象上执行相同的操作
  - MIMD Multiple Instruction Multiple Data (multi-threading or multi-processing)
    - 同时在多个对象上执行多个操作
- 由于事例独立性使得高能物理数据处理具有天然并行性,通常采用粗粒度的并行化
  - 将一个任务分成多个作业,同时运行(作业并行)
  - 在一个作业内部同时处理多个事例(事例间并行)
  - 在一个事例上同时执行多个操作(事例内并行)
- 现代计算机硬件需要更加细粒度的并行,比如超级计算、数千个GPU卡并行
  - 比如"太湖之光"的主从核的众核架构等
  - 需要根据物理问题, 重新思考新的架构与算法





# 异构编程

- 目前,已有多种并行硬件架构
- CPU并行指令集各不相同
  - X86: SSE4.2 (Streaming SIMD Extensions), AVX (Intel Advanced Vector Extensions), AVX2, AVX512
  - ARM: NEON, SVE (Scalable Vector Extension)
  - Others: VMX(Altivec), VSX (power7)
- GPU/FPGA架构
  - Nvidia, AMD, Intel, Sugon, Xilinx, Altera(Intel), ...
- 其它超越冯诺依曼架构的体系,比如Intel CSA
- 各种编程框架
  - CUDA, TBB, OpenACC, OpenMP, OpenCL (→Vulcan), Kokkos, ...
  - HIP (sugon DCU), Verilog, vivada/vitis, ...
  - Hadoop, Spark, STORM, ...



## 开源软件

- 高能物理贡献了很多开源软件
  - 存储、计算、网络、数据分析等
  - GEANT4, ROOT, RUCIO, CVMFS, EOS, dCache, CASTOR, ...
- 使用大量的业界开源系统
  - Openstack, CEPH, Hadoop, Spark, ...
- 与业界开源软件互相融合,取长补短
  - 业界的开源社区活跃, 文档齐全
- 挑战: 如何整合开源软件,长期发展







**ExCALIBUR-HEP** 











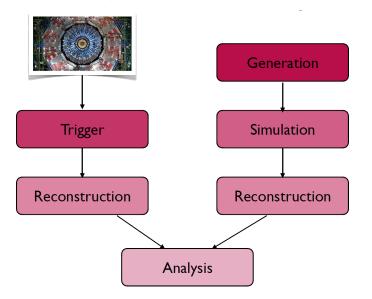


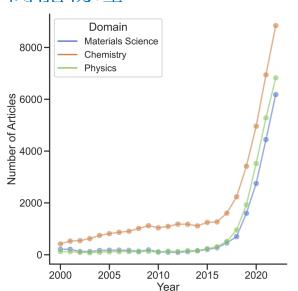




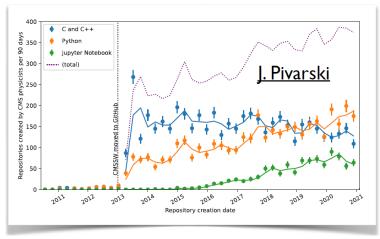
# 数据科学与机器学习

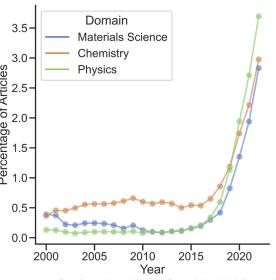
- 今年来,数据科学与机器学习蓬勃发展
  - 算法、算力、数据组成计算智能
- Python已经变成了数据科学的基本语言
  - 社区活跃, 文档丰富
  - Numpy, matplotlib, pytorch, tensorflow, etc
- 上世纪90年代, 高能物理领域开始机器学习技术
- 目前, 机器学习已广泛应用于高能物理











Ben Blaiszik, "2021 AI/ML Publication Statistics and Charts". Zenodo, Sep. 07, 2022. doi: 10.5281/zenodo.7057437.

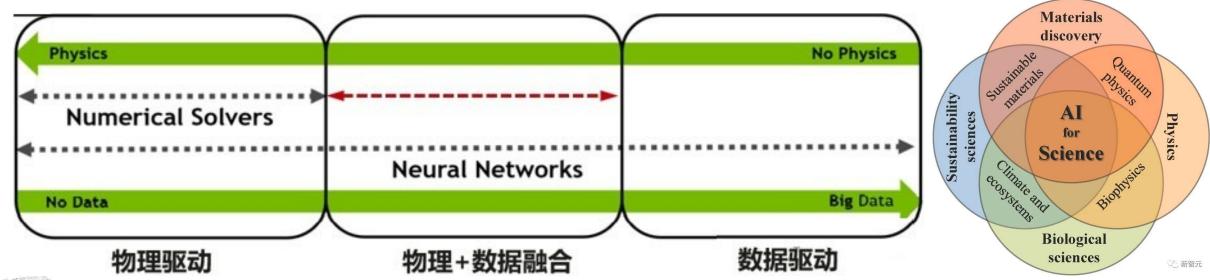


## AI4Science

- AI4Science顾名思义:将大数据、机器学习、深度学习等人工智能技术应用到科学研究中
- AI处理多维、多模态的海量数据,不仅将加速科研流程,还将帮助发现新的科学规律
- AI4Science不仅仅是将AI应用到Science,而是两者相互影响与耦合,共同发展
- DeepMind最新研究登Nature,揭示AI时代科研新范式,开拓未知领域,孕育科技革命, 其中包括数据采集、数据选择、数据标注、数据生成以及<mark>粒子物理应用</mark>等

Review Published: 02 August 2023

Scientific discovery in the age of artificial intelligence <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-023-06221-2">https://www.nature.com/articles/s41586-023-06221-2</a>



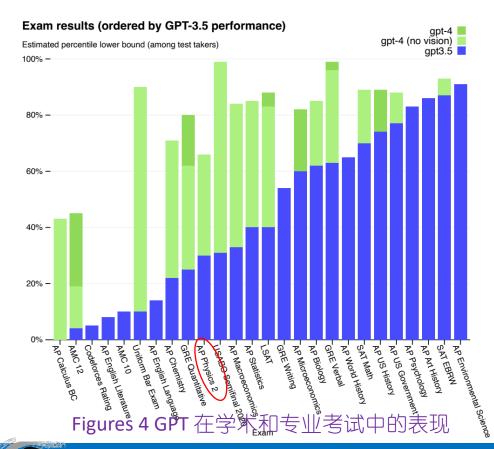
## **ChatGPT**

如果问最近最火爆的科技热点是什么?非ChatGPT莫属。

#### ChatGPT是由OpenAI发布的人工智能对话生成系统。

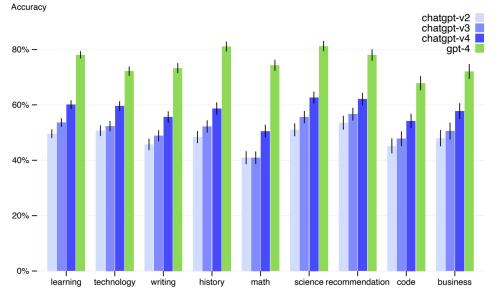
聊天、写代码、修改bug、做表格、发论文、写作业、做翻译,无所不能...

### Chat GPT可以做物理吗?



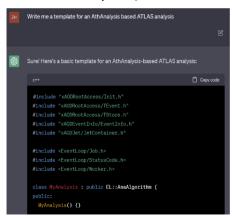
"尽管 GPT-4 具有多种功能,但它与早期的 GPT 模型具有类似的局限性。 最重要的是,它仍然不完全可靠" 跨学科准确率约为 75% (图 6)

#### Internal factual eval by category



Already useful in HEP IV

Generate ATLAS analysis template



OpenAl 2023年论文

https://arxiv.org/pdf/2303.08774.pdf

# NISQ量子计算时代

- 含噪声的中型量子时代(Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ)
  - 50-100 Qubit, 高噪声
  - 在高能物理领域,在Tracking, Analysis等方面已有应用

Article Open Access | Published: 14 June 2023

## Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance

Youngseok Kim ≅, Andrew Eddins ≅, Sajant Anand, Ken Xuan Wei, Ewout van den Berg, Sami Rosenblatt, Hasan Nayfeh, Yantao Wu, Michael Zaletel, Kristan Temme & Abhinav Kandala ≅

Nature 618, 500–505 (2023) | Cite this article

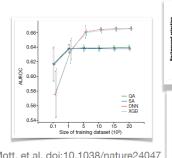
8/17/2023

(金)新智元

2023年6月,IBM首次验证100+ 量子比特,无需纠错,依然可 取得精确结果,甚至超越经典 计算机

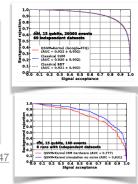
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06096-3

#### Analysis with ML



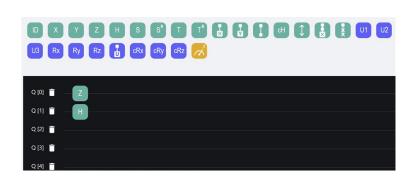


Zlokapa et al, arXiv: 1908.04480



Material courtesy of S.L.Wu, publication coming soon

## • 动手编写量子程序: https://qc.ihep.ac.cn/



```
1 OPENQASM 2.0;
2 include "qelib1.inc";
3 qreg q[5];
4 creg c[5];
5 z q[0];
6 h q[1];
```





## 总结

- 高能物理计算涉及到计算机体系结构、计算机软件与理论、科学数据处理等 多个学科方向
- 计算、存储、网络是基础设施,数据是核心,软件框架是中间件,数据分析是顶层应用,科学发现是最终目标
- 本次暑期培训包括各类实验数据处理(粒子物理、天文实验、光源实验、宇宙线等),各种计算技术(高性能计算、数据存储与管理、网络与安全、软件框架、CUDA/HPC、异构计算、AI以及大模型等),内容丰富
- 采用先进的技术,进行规范的使用,以提高数据处理的效率,促进科学发现

